산업통상자원부 보도참고자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 배포즉시 배포 2024. 12. 6.(금)

미 반도체장비 수출통제 관련 업계 영향 점검 및 대응방안 논의

- 기업의 수출 애로 해소 등 지원방안 모색 -

산업통상자원부(장관 안덕근, 이하 산업부)는 지난 12.2일(월, 현지시각) 미국이 첨단 반도체장비에 대한 수출통제 조치 개정안을 발표함에 따라, 첨단산업정책관 주재로 12월 6일(금) 서울에서 반도체장비 업계와 간담회를 개최하여 우리 기업에 대한 영향을 점검하고 향후 대응방안을 논의하였다.

【 미국 수출통제 조치 관련 】

미국의 이번 조치는 ▲고대역폭메모리(HBM)에 대한 통제를 새롭게 도입하고, ▲미국의 우려거래자 목록(Entity List)을 확대하는 한편,

▲기존의 첨단 반도체장비 통제를 확대하기 위해 새로운 반도체장비 24종 및 이와 관련된 소프트웨어 3종 등을 수출통제 대상 품목으로 새롭게 추가하고, ▲이번 HBM 및 반도체장비 수출통제 조치에 '해외직접생산품규칙(Foreign Direct Product Rule, FDPR)'을 적용한다는 내용이다.

※ HBM 및 반도체장비 수출통제는 '25년 1월 1일부터 시행

이번 조치는 미국이 국가안보적 관점에서 독자적으로 시행하는 것이나, 우리 기업에 미치는 영향 등을 고려해 한미 양국은 그간 긴밀히 협의해왔다. 특히, 정부는 우리 업계와 수시로 소통하며 의견을 수렴하고, 이를 토대로 정부간 협의시 우리 입장을 충분히 전달하고 반영하기 위해 노력해왔다.

오늘 간담회에서 업계는 미국의 수출통제 내용이 확정되고 정부간 협의 과정에서 업계 입장도 일정 부분 반영되어 불확실성이 다소간 해소된 것으로 평가하면서, 글로벌 무역안보 규범이 강화되고 있는 만큼 규범을 준수하면서도 그 안에서 새로운 대응전략을 모색해 나가겠다고 밝혔다. 아울러, 소부장 지원정책과 관련해서 정부의 지속적인 관심을 요청했다.

【 반도체 소부장(소재·부품·장비) 지원방안 】

이에 정부는 최근 발표해서 추진중인 반도체산업 지원정책을 설명하고, 반도체 소부장 경쟁력 제고를 위한 지원을 대폭 강화하겠다고 강조했다.

우선, 반도체 소부장 업계의 오랜 숙원인 약 1조원 규모의 “첨단반도체 테스트베드-트리니티 팹”을 내년부터 본격 구축한다. 업계가 개발한 소부장 제품을 양산 팹과 동일한 환경에서 평가·검증하여 실제 양산으로 이어질 수 있도록 뒷받침할 예정이다. 또한, 첨단기술 확보를 위해 첨단패키징 등 R&D를 적극 지원하고, 사업화를 위한 투자도 지속 강화할 계획이다.

* 첨단반도체 양산연계형 미니팹 기반구축사업 (’25~’31, 약 1조원(민자 건축·시설 포함), 예타 통과)
* 반도체 첨단패키징 선도기술개발사업 (’25~’31, 총 2,744억원 (’25년 정부안 178억원))
* 양산성능평가지원사업(’25년 정부안 450억원), 국가첨단전략산업 기술혁신융자사업 (’25년 정부안 1,200억원, 대출금리 1.3%(’24.4분기 기준)) 등 사업화 지원

아울러, 「반도체 생태계 지원 강화방안」(’24.11.27일 발표)에 따라 반도체 소부장 기업의 투자와 성장을 지원한다. 저리대출 프로그램(’25년 4.25조원), 반도체 생태계 펀드(‘25년 총 4,200억원) 등 금융지원을 확대할 예정이다. 그리고, 국회와 협의하여 반도체 기업(소부장 포함)에 대한 국가전략기술 투자 세액공제율을 상향하는 방안을 추진하고, 반도체 소부장 분야의 국가전략기술 범위를 확대하는 등 세제지원도 대폭 강화할 계획이다.

간담회에 참석한 기업들은 국가전략기술 세액공제 확대시 미래 투자에 도움이 될 것이라며, 특히 정부가 대규모 재원을 투자하는 트리니티 팹은 소부장 기업이 사업영역을 확장할 수 있는 획기적인 계기가 될 것이라고 평가했다.

다만, 업계는 미국 신정부 출범 이후 정책 변화 가능성을 전망하며, 정부가 업계의 이익을 보호하고 불확실성 우려를 낮추는 데 힘써줄 것과 반도체 분야 연구인력의 근무형태 자율성 제고를 위해 국회에서 논의중인 「반도체 특별법」의 조속한 입법을 위해 노력해줄 것을 요청하였다.

산업부는 미국 수출통제 조치의 영향을 지속 점검하는 한편, 반도체 소부장 업계의 애로 해소와 경쟁력 강화를 위해 적극 지원할 계획이다.

※ “수출통제 상담창구” 대표번호는 반도체산업협회 ☎(02-570-5232), 무역안보관리원 ☎(02-6000-6498)이며, 무역안보관리원 홈페이지에 수출통제 관련 정보 게재 예정

담당 부서	산업통상자원부 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	서기관	이보라 (044-203-4271)
			사무관	배재형 (044-203-4141)
			주무관	이수연 (044-203-4143)
	산업통상자원부 무역안보정책과	책임자	과 장	김정예 (044-203-4830)
		담당자	사무관	방규철 (044-203-4832)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시
공공누리 공공저작물 자유이용허락

붙임 **반도체장비 업계 간담회 개요**

□ **목 적**

○ 미국 반도체장비 수출통제 관련 업계 영향 점검 및 대응방안 논의

□ **일 시** : ’24. 12. 6.(금) 09:30 ~ 10:30 (60분)

□ **장 소** : 기술센터 16층 대회의실 (서울 강남구 테헤란로 305)

□ **참석자**

○ (정부) 산업부 첨단산업정책관(주재), 무역안보정책과장

○ (기관/단체) 한국반도체산업협회, 무역안보관리원

○ (업계) 원익IPS, 주성엔지니어링, 테스, 세메스, 피에스케이, 브이엠, 오로스테크놀로지, 서플러스글로벌 등

□ **세부 일정**

시간		주요 내용	비고
09:30~09:35	(5분)	모두 발언	첨단산업정책관
09:35~09:45	(10분)	동향 보고	무역안보관리원
09:45~10:30	(45분)	자유토론 및 질의응답	참석자 전원